

# SEMICON<sup>®</sup> JAPAN 2023

## ジェーイーエル出展機一覧



会社案内  
製品カタログ



### φ200 mm SMIF POD 対応システム **SSY**

- SMIFオープナで、PODの開閉が可能
- 5軸水平多関節クリーン搬送ロボットを搭載し、3Portまで対応可能
- 工場側とGEM300規格等の対応可能
- 保持方式: 真空吸着



### 高精度アライナ **SAL-HV**

- 多種多様なウェーハのアライメントが可能
- 高精度モード、通常モードの切り替えが可能
- 精度: **高精度モード** センタリング ±0.05 mm以内  
ノッチロケート ±0.05度以内  
位置決め時間 約8秒
- **通常モード** センタリング ±0.1 mm以内  
ノッチロケート ±0.1度以内  
位置決め時間 約3秒
- 保持方式: 真空吸着



### ウェーハアライメント対応 真空搬送ロボット **STVCR**

- 外付けのアライメントセンサにより、ウェーハを中心位置補正した状態で搬送可能
- ツインアーム採用により、ワーク交換時間の短縮
- 真空度:  $1.33 \times 10^{-6}$  Pa
- 保持方式: 落とし込み、樹脂パットによる摩擦保持
- アーム、昇降ストローク: お問い合わせください



### TAIKO<sup>™</sup>、薄物ウェーハ 搬送ロボット **STCR**

※TAIKO<sup>™</sup>は、株式会社ディスコ(DISCO Corporation)の商標または登録商標です。

- 保持方法の選択性向上
- 多様なワーク搬送に対応可能
- 大流量、多配線化、剛性UPにより、大流量型ベルヌーイ、各種センサ搭載等に対応
- 可搬質量4kg(従来機比1.3倍)
- 保持方式: ベルヌーイ(接触、非接触)
- 配管本数: 配管外径φ6×4本
- アーム、昇降ストローク: お問い合わせください

# SEMICON<sup>®</sup> JAPAN 2023

## List of JEL exhibition robot



company profile &  
product information



### SSY

- System with  $\phi$ 200mm SMIF POD -

- POD opens/closes with SMIF opener
- Up to 3 ports access is available with 5-Axis Horizontal and Multi-Joint Type Clean Robot
- Communication with factory host using GEM300 standards is available
- Wafer holding: Vacuum suction



### SAL-HV

- High accuracy pre-aligner -

- Available for various material wafers
- High accuracy mode and normal mode are selectable
- Positioning accuracy:
  - High accuracy mode** Centering: Within +/-0.05mm  
Notch locating: Within +/-0.05 degrees  
Positioning time: Centering: Approx. 8 sec.
  - Normal mode** Centering: Within +/-0.1mm  
Notch locating: Within +/-0.1 degrees.  
Positioning time: Centering: Approx. 3 sec.

- Wafer holding: Vacuum suction



### STVCR

- Vacuum robot with wafer alignment function -

- Enable to handle wafers correcting the wafer center position with the external alignment sensors
- Twin arm reduces the wafer swap time
- Vacuum resistance:  $1.33 \times 10^{-6}$  Pa
- Wafer holding: Passive edge, friction holding by resin pads
- Arm length, Z-axis stroke: Please ask us.



### STCR

- TAIKO<sup>™</sup> and thin wafer handling robot -

"TAIKO<sup>™</sup>" is a trademark or registered trademark of DISCO Corporation.

- Improved selectivity of wafer holdings
- Enable to handle various wafers
- Capable of installing large flow type Bernoulli or various sensors by increasing of flow rate, rigidity, and multi-wirings
- Payload capacity: 4 kg (1.3 times compared to existing model)
- Wafer holding: Bernoulli (Contact and non-contact type)
- Air lines:  $\phi$ 6mm $\times$ 4 lines
- Arm length, Z-axis stroke: Please ask us.